

SNx4HC244 3 ステート出力、オクタール・バッファ/ライン・ドライバ

1 特長

- 広い動作電圧範囲: 2V~6V
- 大電流出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- バス・ラインまたはバッファ・メモリ・アドレス・レジスタを駆動できる 3 ステート出力
- 低い消費電力: $I_{CC} = 80\mu\text{A}$ (最大値)
- $t_{pd} = 11\text{ns}$ (標準値)
- 5V で $\pm 6\text{mA}$ の出力駆動能力
- 低い入力電流: 最大値 $1\mu\text{A}$
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。

2 アプリケーション

- サーバー
- LED ディスプレイ
- ネットワーク・スイッチ
- 通信インフラ
- モータ・ドライバ
- I/O エクスパンダ

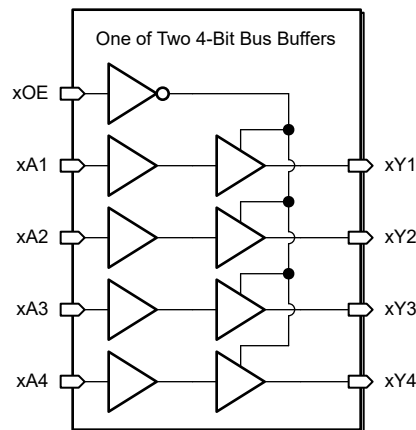
3 概要

SNx4HC244 オクタール バッファ/ラインドライバは、3 ステート メモリ アドレスドライバ、クロックドライバ、バス用レシーバ/トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。SNx4HC244 デバイスは、独立した出力イネーブル ($\overline{\text{OE}}$) 入力を備えた 2 つの 4 ビット バッファ/ドライバで構成されています。 $\overline{\text{OE}}$ が Low の場合、デバイスは A 入力からの非反転型データを Y 出力に渡します。 $\overline{\text{OE}}$ が High の場合、出力は高インピーダンス状態になります。

製品情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージサイズ ⁽²⁾	本体サイズ ⁽³⁾
SN54HC244	J (CDIP, 20)	24.38mm × 7.62mm	24.38mm × 6.92mm
	W (CFP, 20)	13.72mm × 8.13mm	13.72mm × 6.92mm
	FK (LCCC, 20)	8.89mm × 8.89mm	8.89mm × 8.89mm
SN74HC244	DB (SSOP, 20)	7.2mm × 7.8mm	7.2mm × 5.3mm
	DW (SOIC, 20)	12.80mm × 10.3mm	12.8mm × 7.5mm
	N (PDIP, 20)	24.33 mm × 9.4mm	24.33mm × 6.35mm
	NS (SOP, 20)	12.6mm × 7.8mm	12.6mm × 5.3mm
	PW (TSSOP, 20)	6.5mm × 6.4mm	6.5mm × 4.4mm

- (1) 詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
- (2) パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値で、該当する場合はピンも含まれます。
- (3) 本体サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



論理図 (正論理)



目次

1 特長	1	7.1 概要.....	12
2 アプリケーション	1	7.2 機能ブロック図.....	12
3 概要	1	7.3 機能説明.....	12
4 ピン構成および機能	3	7.4 デバイスの機能モード.....	12
5 仕様	4	8 アプリケーションと実装	14
5.1 絶対最大定格.....	4	8.1 アプリケーション情報.....	14
5.2 ESD 定格.....	4	8.2 代表的なアプリケーション.....	14
5.3 推奨動作条件.....	4	8.3 電源に関する推奨事項.....	15
5.4 熱に関する情報.....	5	8.4 レイアウトのガイドライン.....	15
5.5 電気的特性.....	5	9 デバイスおよびドキュメントのサポート	17
5.6 電気的特性 - SN54HC244.....	5	9.1 ドキュメントのサポート.....	17
5.7 電気的特性 - SN74HC244.....	6	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	17
5.8 スイッチング特性.....	6	9.3 サポート・リソース.....	17
5.9 スイッチング特性 - $C_L = 50\text{pF}$	8	9.4 商標.....	17
5.10 スイッチング特性 - $C_L = 150\text{pF}$	8	9.5 静電気放電に関する注意事項.....	17
5.11 代表的特性.....	9	9.6 用語集.....	17
6 パラメータ測定情報	10	10 改訂履歴	17
7 詳細説明	12	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報	18

4 ピン構成および機能

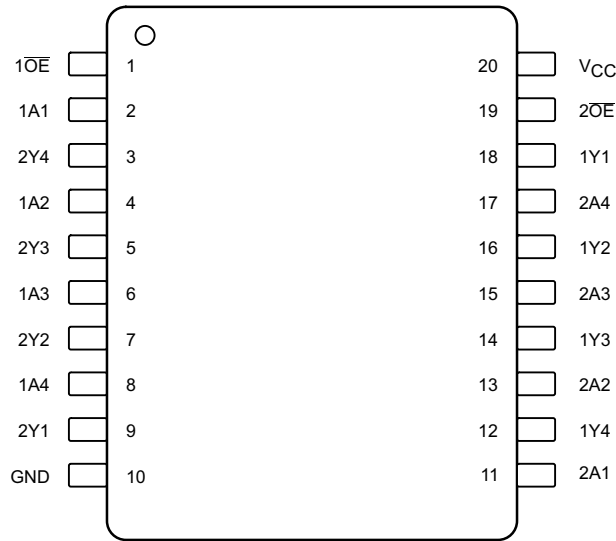


図 4-1. DB、DW、J、N、NS、PW、W パッケージ 20 ピン SSOP、SOIC、CDIP、PDIP、SOP、TSSOP または CFP (上面図)

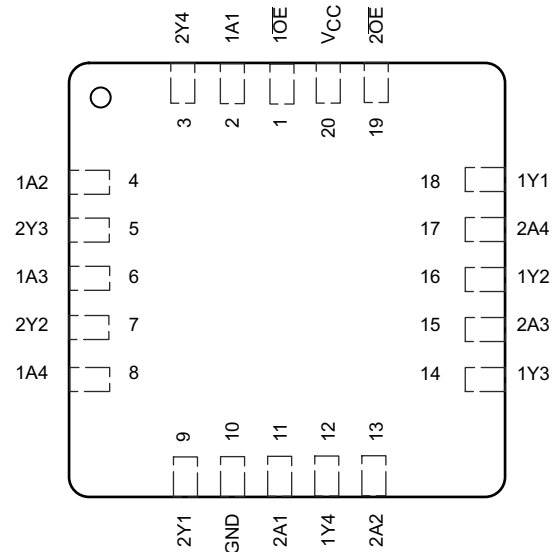


図 4-2. FK パッケージ 20 ピン LCCC 上面図

ピン		I/O ⁽¹⁾	説明
番号	名称		
1	1 OE	I	出力イネーブル
2	1A1	I	入力
3	2Y4	O	出力
4	1A2	I	入力
5	2Y3	O	出力
6	1A3	I	入力
7	2Y2	O	出力
8	1A4	I	入力
9	2Y1	O	出力
10	GND	—	グラウンド
11	2A1	I	入力
12	1Y4	O	出力
13	2A2	I	入力
14	1Y3	O	出力
15	2A3	I	入力
16	1Y2	O	出力
17	2A4	I	入力
18	1Y1	O	出力
19	2 OE	I	出力イネーブル
20	V _{CC}	—	パワー ピン

(1) 信号タイプ: I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力。

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
電源電圧範囲、 V_{CC}		-0.5	7	V
入力クランプ電流、 I_{IK}	$V_I < 0$ または $V_I > V_{CC}$ ⁽²⁾		±20	mA
出力クランプ電流、 I_{OK}	$V_O < 0$ または $V_O > V_{CC}$ ⁽²⁾		±20	mA
連続出力電流、 I_O	$V_O = 0$ または V_{CC}		±35	mA
V_{CC} または GND を通過する連続電流			±70	mA
接合部温度、 T_J			150	°C
保管温度、 T_{stg}		-65	150	°C

(1) 絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについての話で、絶対最大定格において、またはこのデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。

(2) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

5.2 ESD 定格

SN74HC244		値	単位
$V_{(ESD)}$ 静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ⁽¹⁾	±2000	V
	デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠 ⁽²⁾	±1000	

(1) JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

(2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

		最小値	公称値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧	2	5	6	V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 2\text{ V}$	1.5		V
		$V_{CC} = 4.5\text{ V}$	3.15		
		$V_{CC} = 6\text{ V}$	4.2		
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 2\text{ V}$		0.5	V
		$V_{CC} = 4.5\text{ V}$		1.35	
		$V_{CC} = 6\text{ V}$		1.8	
V_I	入力電圧	0		V_{CC}	V
V_O	出力電圧	0		V_{CC}	V
$\Delta t/\Delta v$	入力遷移の立ち上がり時間と立ち下がり時間	$V_{CC} = 2\text{ V}$		1000	ns/V
		$V_{CC} = 4.5\text{ V}$		500	
		$V_{CC} = 6\text{ V}$		400	
C_{pd}	バッファまたはドライバごとの消費電力容量 (負荷なし)		35		pF
T_A	自由空気での動作温度	SN54HC244	-55	125	°C
		SN74HC244	-40	85	

(1) デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、 V_{CC} または GND に固定する必要があります。テキサス インストルメンツのアプリケーションレポート、「低速またはフローティング CMOS 入力の影響」、SCBA004 を参照してください。

5.4 熱に関する情報

熱評価基準		SN74HC244					単位
		DW (SOIC)	DB (SSOP)	N (PDIP)	NS (SO)	PW (TSSOP)	
		20 ピン	20 ピン	20 ピン	20 ピン	20 ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗 ⁽¹⁾	109.1	122.7	84.6	113.4	131.8	°C/W
$R_{\theta JC (top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	76	81.6	72.5	78.6	72.2	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	77.6	77.5	65.3	78.4	82.8	°C/W
Ψ_{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	51.5	46.1	55.3	47.1	21.5	°C/W
Ψ_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	77.1	77.1	65.2	78.1	82.4	°C/W
$R_{\theta JC (bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	°C/W

(1) 従来および最新の熱測定基準の詳細については、アプリケーションレポート『半導体および IC パッケージの熱評価基準』、SPRA953 を参照してください。

5.5 電気的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
V_{OH}	$V_I = V_{IH}$ または V_{IL}	$I_{OH} = -20\mu\text{A}$	$V_{CC} = 2\text{V}$	1.9	1.998	V
			$V_{CC} = 4.5\text{V}$	4.4	4.499	
			$V_{CC} = 6\text{V}$	5.9	5.999	
		$I_{OH} = -6\text{mA}, V_{CC} = 4.5\text{V}$	3.98	4.3		
		$I_{OH} = -7.8\text{mA}, V_{CC} = 6\text{V}$	5.48	5.8		
V_{OL}	$V_I = V_{IH}$ または V_{IL}	$I_{OL} = 20\mu\text{A}$	$V_{CC} = 2\text{V}$	0.002	0.1	V
			$V_{CC} = 4.5\text{V}$	0.001	0.1	
			$V_{CC} = 6\text{V}$	0.001	0.1	
		$I_{OL} = 6\text{mA}, V_{CC} = 4.5\text{V}$	0.17	0.26		
		$I_{OL} = 7.8\text{mA}, V_{CC} = 6\text{V}$	0.15	0.26		
I_I	$V_I = V_{CC}$ または $0, V_{CC} = 6\text{V}$		± 0.1	± 100	nA	
I_{OZ}	$V_O = V_{CC}$ または $0, V_I = V_{IH}$ または $V_{IL}, V_{CC} = 6\text{V}$		± 0.01	± 0.5	μA	
I_{CC}	$V_I = V_{CC}$ または $0, I_O = 0, V_{CC} = 6\text{V}$			8	μA	
C_i	$V_{CC} = 2\text{V} \sim 6\text{V}$			3	10	pF

5.6 電気的特性 - SN54HC244

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
V_{OH}	$V_I = V_{IH}$ または V_{IL}	$I_{OH} = -20\mu\text{A}$	$V_{CC} = 2\text{V}$	1.9		V
			$V_{CC} = 4.5\text{V}$	4.4		
			$V_{CC} = 6\text{V}$	5.9		
		$I_{OH} = -6\text{mA}, V_{CC} = 4.5\text{V}$	3.7			
		$I_{OH} = -7.8\text{mA}, V_{CC} = 6\text{V}$	5.2			

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
V_{OL}	$V_I = V_{IH}$ または V_{IL}	$I_{OL} = 20\mu A$	$V_{CC} = 2V$		0.1	V
			$V_{CC} = 4.5V$		0.1	
			$V_{CC} = 6V$		0.1	
		$I_{OL} = 6mA, V_{CC} = 4.5V$			0.4	
		$I_{OL} = 7.8mA, V_{CC} = 6V$			0.4	
I_I	$V_I = V_{CC}$ または $0, V_{CC} = 6V$				± 1000	nA
I_{OZ}	$V_O = V_{CC}$ または $0, V_I = V_{IH}$ または $V_{IL}, V_{CC} = 6V$				± 10	μA
I_{CC}	$V_I = V_{CC}$ または $0, I_O = 0, V_{CC} = 6V$				160	μA
C_i	$V_{CC} = 2V \sim 6V$				10	pF

5.7 電気的特性 - SN74HC244

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
V_{OH}	$V_I = V_{IH}$ または V_{IL}	$I_{OH} = -20\mu A$	$V_{CC} = 2V$	1.9		V
			$V_{CC} = 4.5V$	4.4		
			$V_{CC} = 6V$	5.9		
		$I_{OH} = -6mA, V_{CC} = 4.5V$		3.84		
		$I_{OH} = -7.8mA, V_{CC} = 6V$	5.34			
V_{OL}	$V_I = V_{IH}$ または V_{IL}	$I_{OL} = 20\mu A$	$V_{CC} = 2V$		0.1	V
			$V_{CC} = 4.5V$		0.1	
			$V_{CC} = 6V$		0.1	
		$I_{OL} = 6mA, V_{CC} = 4.5V$		0.33		
		$I_{OL} = 7.8mA, V_{CC} = 6V$	0.33			
I_I	$V_I = V_{CC}$ または $0, V_{CC} = 6V$				± 1000	nA
I_{OZ}	$V_O = V_{CC}$ または $0, V_I = V_{IH}$ または $V_{IL}, V_{CC} = 6V$				± 5	μA
I_{CC}	$V_I = V_{CC}$ または $0, I_O = 0, V_{CC} = 6V$				80	μA
C_i	$V_{CC} = 2V \sim 6V$				10	pF

5.8 スイッチング特性

 $T_A = 25^\circ C$ (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
t_{pd}	A (入力) から Y (出力) まで	$V_{CC} = 2V$	$C_L = 50pF$	40	115	ns
			$C_L = 150pF$	56	165	
		$V_{CC} = 4.5V$	$C_L = 50pF$	13	23	
			$C_L = 150pF$	18	33	
		$V_{CC} = 6V$	$C_L = 50pF$	11	20	
			$C_L = 150pF$	15	28	
t_{en}	\overline{OE} (入力) から Y (出力) まで	$V_{CC} = 2V$	$C_L = 50pF$	75	150	ns
			$C_L = 150pF$	100	200	
		$V_{CC} = 4.5V$	$C_L = 50pF$	15	30	
			$C_L = 150pF$	20	40	
		$V_{CC} = 6V$	$C_L = 50pF$	13	26	
			$C_L = 150pF$	17	34	

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
t_{dis}	$\overline{\text{OE}}$ (入力) から Y (出力) まで	$V_{\text{CC}} = 2\text{ V}$	$C_L = 50\text{ pF}$	75	150	ns
		$V_{\text{CC}} = 4.5\text{ V}$	$C_L = 50\text{ pF}$	15	30	
		$V_{\text{CC}} = 6\text{ V}$	$C_L = 50\text{ pF}$	13	26	
t_t	Y まで (出力)	$V_{\text{CC}} = 2\text{ V}$	$C_L = 50\text{ pF}$	28	60	ns
			$C_L = 150\text{ pF}$	45	210	
		$V_{\text{CC}} = 4.5\text{ V}$	$C_L = 50\text{ pF}$	8	12	
			$C_L = 150\text{ pF}$	17	42	
		$V_{\text{CC}} = 6\text{ V}$	$C_L = 50\text{ pF}$	6	10	
			$C_L = 150\text{ pF}$	13	36	

5.9 スイッチング特性 - $C_L = 50\text{pF}$

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り、[図 6-1](#) を参照してください)

パラメータ	テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
t_{pd}	A (入力) から Y (出力) まで	$V_{CC} = 2\text{ V}$	SN54HC244		170	ns
			SN74HC244		145	
		$V_{CC} = 4.5\text{ V}$	SN54HC244		34	
			SN74HC244		29	
		$V_{CC} = 6\text{ V}$	SN54HC244		29	
			SN74HC244		25	
t_{en}	\overline{OE} (入力) から Y (出力) まで	$V_{CC} = 2\text{ V}$	SN54HC244		225	ns
			SN74HC244		190	
		$V_{CC} = 4.5\text{ V}$	SN54HC244		45	
			SN74HC244		38	
		$V_{CC} = 6\text{ V}$	SN54HC244		38	
			SN74HC244		32	
t_{dis}	\overline{OE} (入力) から Y (出力) まで	$V_{CC} = 2\text{ V}$	SN54HC244		225	ns
			SN74HC244		190	
		$V_{CC} = 4.5\text{ V}$	SN54HC244		45	
			SN74HC244		38	
		$V_{CC} = 6\text{ V}$	SN54HC244		38	
			SN74HC244		32	
t_t	Y まで (出力)	$V_{CC} = 2\text{ V}$	SN54HC244		90	ns
			SN74HC244		75	
		$V_{CC} = 4.5\text{ V}$	SN54HC244		18	
			SN74HC244		15	
		$V_{CC} = 6\text{ V}$	SN54HC244		15	
			SN74HC244		13	

5.10 スイッチング特性 - $C_L = 150\text{pF}$

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り、[図 6-1](#) を参照してください)

パラメータ	テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
t_{pd}	A (入力) から Y (出力) まで	$V_{CC} = 2\text{ V}$	SN54HC244		245	ns
			SN74HC244		210	
		$V_{CC} = 4.5\text{ V}$	SN54HC244		49	
			SN74HC244		42	
		$V_{CC} = 6\text{ V}$	SN54HC244		42	
			SN74HC244		35	
t_{en}	\overline{OE} (入力) から Y (出力) まで	$V_{CC} = 2\text{ V}$	SN54HC244		300	ns
			SN74HC244		250	
		$V_{CC} = 4.5\text{ V}$	SN54HC244		60	
			SN74HC244		50	
		$V_{CC} = 6\text{ V}$	SN54HC244		51	
			SN74HC244		43	

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り、[図 6-1](#) を参照してください)

パラメータ	テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
t_t	Y まで (出力)	$V_{CC} = 2\text{ V}$	SN54HC244		315	ns
			SN74HC244		265	
		$V_{CC} = 4.5\text{ V}$	SN54HC244		63	
			SN74HC244		53	
		$V_{CC} = 6\text{ V}$	SN54HC244		53	
			SN74HC244		45	

5.11 代表的特性

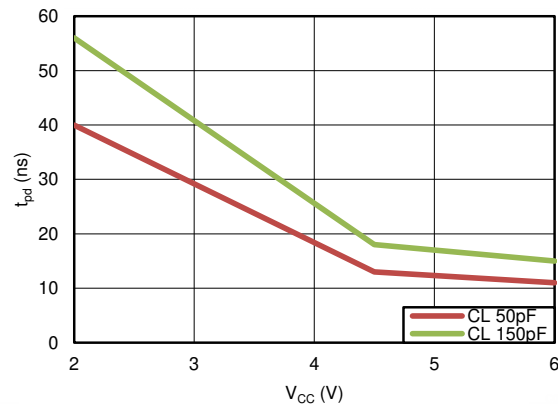


図 5-1. 伝搬遅延

6 パラメータ測定情報

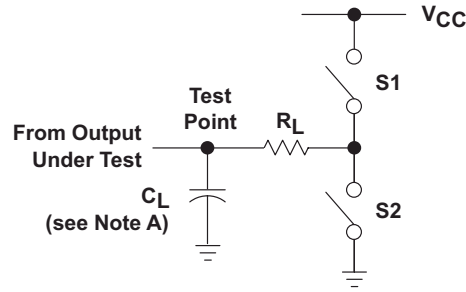


図 6-1. 負荷回路

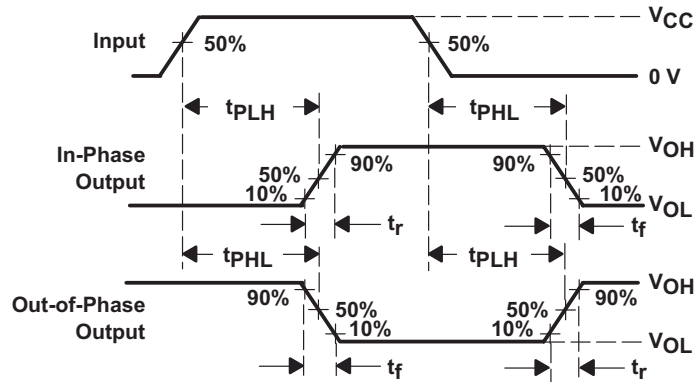


図 6-2. 伝搬遅延と
出力遷移時間

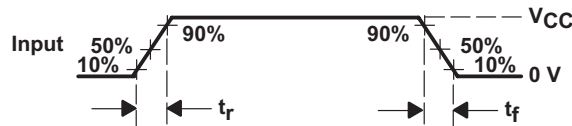


図 6-3. 入力の立ち上がり/立ち下がり時間

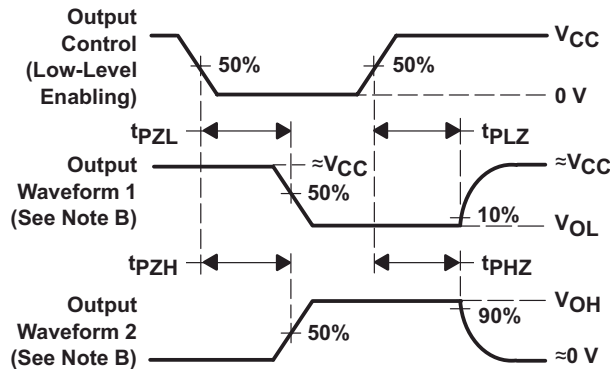


図 6-4. 3 ステート出力の有効化
および無効化時間

注

注:

- A. C_L にはプローブとテスト装置の容量が含まれます。
- B. 波形 1 は、出力が **Low** になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディスエーブルされている場合は除きます。波形 2 は、出力が **High** になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディスエーブルされている場合は除きます。
- C. 波形間の位相関係は、任意に選択されています。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR \leq 1MHz、 $Z_O = 50\Omega$ 、 $t_r = 6ns$ 、 $t_f = 6ns$ 。
- D. 出力は一度に 1 つずつ測定され、測定ごとに 1 つの入力が遷移します。
- E. t_{PLZ} と t_{PHZ} は t_{dis} と同じです。
- F. t_{PZL} と t_{PZH} は t_{en} と同じです。
- G. t_{PLH} と t_{PHL} は t_{pd} と同じです。

表 6-1. スイッチング情報表

パラメータ		RL	CL	S1	S2
t_{en}	t_{PZH}	1k Ω	50pF または 150pF	オープン	クローズド
	t_{PZL}	1k Ω	50pF または 150pF	クローズド	オープン
t_{dis}	t_{PHZ}	1k Ω	50pF	オープン	クローズド
	t_{PLZ}	1k Ω	50pF	クローズド	オープン
t_{pd} または t_t		—	50pF または 150pF	オープン	オープン

7 詳細説明

7.1 概要

SNx4HC244 は、シュミットトリガ入力と 3 ステート出力を備えた 8 つの独立した高速 CMOS バッファを内蔵しています。

各バッファは、ブール論理関数 $xY_n = xA_n$ を実行します。x はバンク番号、n はチャンネル番号です。

各出力イネーブル ($x\overline{OE}$) は 4 つのバッファを制御します。 $x\overline{OE}$ ピンが Low 状態のとき、バンク x のすべてのバッファの出力がイネーブルになります。 $x\overline{OE}$ ピンが High 状態のとき、バンク x のすべてのバッファの出力がディセーブルになります。ディセーブルされた出力はすべて高インピーダンス状態になります。

電源オンまたは電源オフ時にデバイスを高インピーダンス状態にするには、両方の \overline{OE} ピンをプルアップ抵抗経路で V_{CC} に接続します。この抵抗の最小値は、「電気的特性」表に定義されているドライバの電流シンク能力とピンのリーク電流によって決定されます。

7.2 機能ブロック図

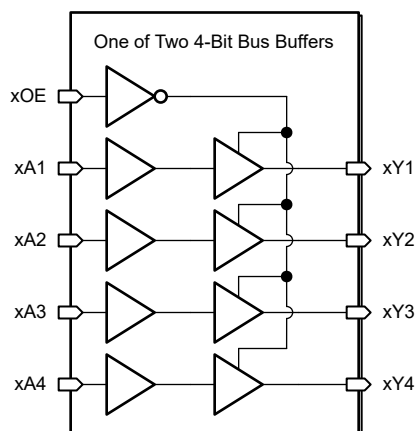


図 7-1. 論理図 (正論理)

7.3 機能説明

7.3.1 標準 CMOS 入力

このデバイスには、標準 CMOS 入力 that 搭載されています。標準 CMOS 入力は高インピーダンスであり、通常は電気的特性に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。ワースト ケースの抵抗は、「絶対最大定格」に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」に示されている最大入力リーク電流からオームの法則 ($R = V \div I$) を使用して計算されます。

標準 CMOS 入力では、「推奨動作条件」表の入力遷移時間またはレートで定義されるように、有効なロジック状態間で入力信号を迅速に遷移させる必要があります。この仕様を満たさないと、消費電力が過剰になり、発振の原因となる可能性があります。詳細については、『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』を参照してください。

動作中は、標準 CMOS 入力をフローティングのままにしないでください。未使用の入力は、 V_{CC} または GND に終端させる必要があります。システムが入力を常にアクティブに駆動している訳ではない場合、システムが入力をアクティブに駆動していないときに有効な入力電圧を与えるため、プルアップまたはプルダウン抵抗を追加できます。抵抗値は複数の要因で決まりますが、10k Ω の抵抗を推奨します。通常はこれですべての要件を満たします。

7.4 デバイスの機能モード

表 7-1 に、SNx4HC244 の機能モードを示します。

表 7-1. 機能表

入力 ⁽¹⁾		出力
OE	A	Y
L	L	L
L	H	H
H	X	Z

(1) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル、X = ドント ケア、Z = 高インピーダンス

8 アプリケーションと実装

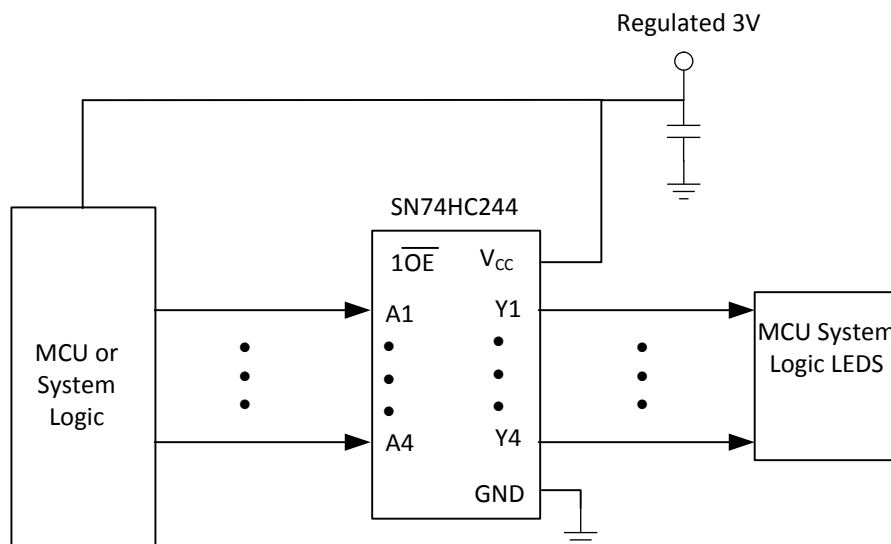
注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

SN74HC244 は出力ドライブまたは PCB パターン長が懸念される多くのバス インターフェイス タイプのアプリケーションで使用できる高駆動能力の CMOS デバイスです。

8.2 代表的なアプリケーション



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

図 8-1. SN74HC244 アプリケーションの回路図

8.2.1 設計要件

このデバイスは CMOS 技術を採用しており、平衡型出力ドライバを備えています。上限値を超える電流が流れる可能性があるため、バスが競合しないように注意します。また、大きな駆動能力で軽負荷を駆動することでも高速なエッジが生じるため、配線と負荷の条件を検討してリングングを防止してください。

8.2.2 詳細な設計手順

- 推奨入力条件:
 - 立ち上がり時間と立ち下がり時間の仕様については、[セクション 5.3](#) 表の $\Delta t/\Delta V$ を参照してください。
 - 規定された High および Low レベルについては、「[セクション 5.3](#)」の V_{IH} および V_{IL} を参照してください。
- 推奨出力条件:
 - 負荷電流は、出力ごとに I_O の最大値を超えないようにする必要があります。また、 V_{CC} または GND を流れる連続電流は、本デバイスの最大総電流の仕様値を超えないようにする必要があります。これらの制限値については、[セクション 5.1](#) で参照するのは可能です。
 - 出力は、 V_{CC} を超えてプルされないようにしてください。

8.2.3 アプリケーション曲線

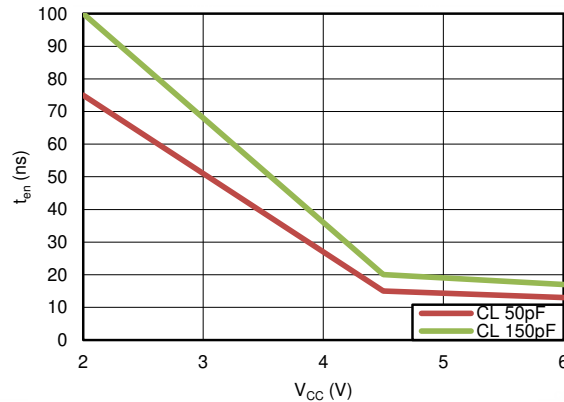


図 8-2. 有効化時間

8.3 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。電源の外乱を防止するため、各 V_{CC} 端子に適切なバイパスコンデンサを配置する必要があります。このデバイスには 0.1μF のコンデンサを推奨します。複数のバイパスコンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。一般的に、0.1μF と 1μF のコンデンサは並列に使用されます。バイパスコンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置すると最適な結果が得られます。

8.4 レイアウトのガイドライン

- バイパスコンデンサの配置
 - デバイスの正電源端子の近くに配置
 - 電氣的に短いグランド帰還パスを提供
 - インピーダンスを最小化するため、広いパターンを使用
 - 可能な場合はいつでも、ボードの同じ側にデバイス、コンデンサ、パターンを配置
- 信号トレースの形状
 - 8mil～12mil のトレース幅
 - 伝送ラインの影響を最小化する 12cm 未満の長さ
 - 信号トレースの 90° のコーナーは避ける
 - 信号トレースの下に、途切れのないグランドプレーンを使用
 - 信号トレース周辺の領域をグランドでフラッドフィル
 - 12cm を超えるパターン用
 - インピーダンス制御トレースを使用
 - 出力の近くに直列ダンピング抵抗を使用して、ソース終端
 - 分岐を回避。個別に分岐が必要なバッファ信号

8.4.1 レイアウト例

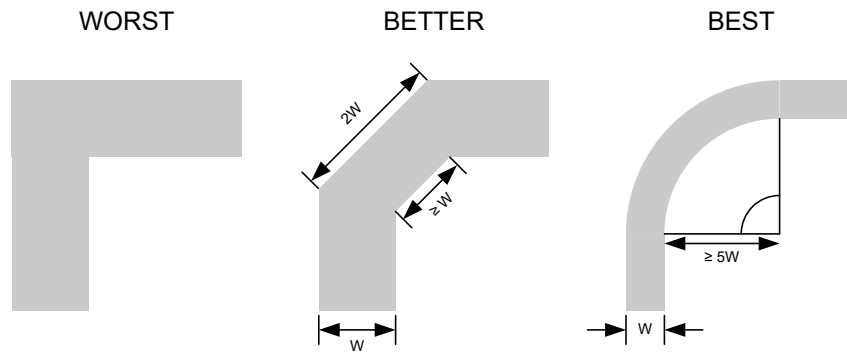


図 8-3. シグナル インテグリティ向上のためのサンプル パターンのコーナー

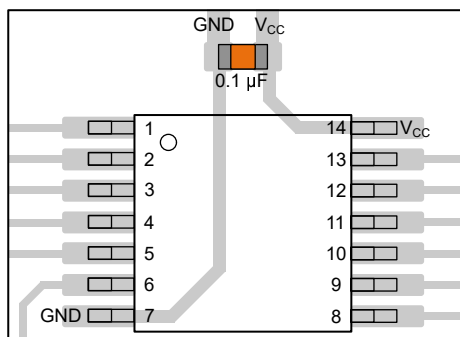


図 8-4. TSSOP や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

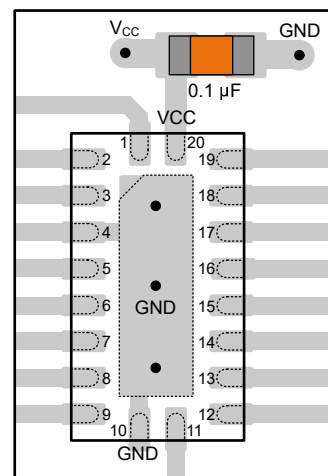


図 8-5. WQFN や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

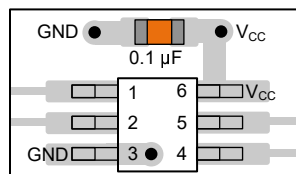


図 8-6. SOT、SC70、および類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

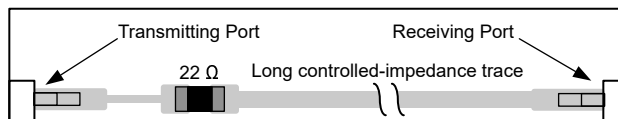


図 8-7. シグナル インテグリティ向上のためのダンピング抵抗の配置例

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 ドキュメントのサポート

9.1.1 関連リンク

表 9-1 に、クイック アクセス リンクの一覧を示します。カテゴリには、技術資料、サポートおよびコミュニティ リソース、ツールとソフトウェア、およびサンプル注文またはご購入へのクイック アクセスが含まれます。

表 9-1. 関連リンク

製品	プロダクトフォルダ	サンプルとご購入	技術資料	ツールとソフトウェア	サポートとコミュニティ
SN54HC244	こちらをクリック	こちらをクリック	こちらをクリック	こちらをクリック	こちらをクリック
SN74HC244	こちらをクリック	こちらをクリック	こちらをクリック	こちらをクリック	こちらをクリック

9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.6 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集 この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision F (May 2022) to Revision G (January 2025)	Page
「製品情報」表にパッケージ サイズを追加し、データシートの構造レイアウトを今の標準に合わせるために更新しました.....	1
更新した「特長の説明」、および修正された「機能ブロック図」画像と「デバイスの機能モード」表.....	12

Changes from Revision E (May 2016) to Revision F (May 2022)**Page**

- 電流機能に合わせてために、接合部から周囲への熱抵抗値が増加しました。..... 5

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
5962-8409601VRA	ACTIVE	CDIP	J	20	20	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8409601VR A SNV54HC244J	Samples
5962-8409601VSA	ACTIVE	CFP	W	20	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8409601VS A SNV54HC244W	Samples
84096012A	ACTIVE	LCCC	FK	20	55	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	84096012A SNJ54HC 244FK	Samples
8409601RA	ACTIVE	CDIP	J	20	20	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	8409601RA SNJ54HC244J	Samples
8409601SA	ACTIVE	CFP	W	20	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	8409601SA SNJ54HC244W	Samples
JM38510/65705B2A	ACTIVE	LCCC	FK	20	55	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	JM38510/ 65705B2A	Samples
JM38510/65705BRA	ACTIVE	CDIP	J	20	20	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	JM38510/ 65705BRA	Samples
JM38510/65705BSA	ACTIVE	CFP	W	20	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	JM38510/ 65705BSA	Samples
M38510/65705B2A	ACTIVE	LCCC	FK	20	55	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	JM38510/ 65705B2A	Samples
M38510/65705BRA	ACTIVE	CDIP	J	20	20	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	JM38510/ 65705BRA	Samples
M38510/65705BSA	ACTIVE	CFP	W	20	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	JM38510/ 65705BSA	Samples
SN54HC244J	ACTIVE	CDIP	J	20	20	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	SN54HC244J	Samples
SN74HC244APWR	ACTIVE	TSSOP	PW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC244A	Samples
SN74HC244DBR	ACTIVE	SSOP	DB	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC244	Samples
SN74HC244DWR	ACTIVE	SOIC	DW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC244	Samples
SN74HC244DWRE4	ACTIVE	SOIC	DW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC244	Samples

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
SN74HC244DWRG4	ACTIVE	SOIC	DW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC244	Samples
SN74HC244N	ACTIVE	PDIP	N	20	20	RoHS & Green	NIPDAU	N / A for Pkg Type	-40 to 85	SN74HC244N	Samples
SN74HC244NE4	ACTIVE	PDIP	N	20	20	RoHS & Green	NIPDAU	N / A for Pkg Type	-40 to 85	SN74HC244N	Samples
SN74HC244NSR	ACTIVE	SOP	NS	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC244	Samples
SN74HC244NSRG4	ACTIVE	SOP	NS	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC244	Samples
SN74HC244PW	OBSOLETE	TSSOP	PW	20		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	HC244	
SN74HC244PWR	ACTIVE	TSSOP	PW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC244	Samples
SN74HC244PWRE4	ACTIVE	TSSOP	PW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC244	Samples
SN74HC244PWRG4	ACTIVE	TSSOP	PW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC244	Samples
SN74HC244PWT	OBSOLETE	TSSOP	PW	20		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	HC244	
SN74HC244QDWRG4Q1	ACTIVE	SOIC	DW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM		HC244Q	Samples
SNJ54HC244FK	ACTIVE	LCCC	FK	20	55	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	84096012A SNJ54HC 244FK	Samples
SNJ54HC244J	ACTIVE	CDIP	J	20	20	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	8409601RA SNJ54HC244J	Samples
SNJ54HC244W	ACTIVE	CFP	W	20	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	8409601SA SNJ54HC244W	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of ≤ 1000 ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the ≤ 1000 ppm threshold requirement.

- (3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.
- (4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.
- (5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.
- (6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN54HC244, SN54HC244-SP, SN74HC244 :

- Catalog : [SN74HC244](#), [SN54HC244](#)
- Automotive : [SN74HC244-Q1](#), [SN74HC244-Q1](#)
- Enhanced Product : [SN74HC244-EP](#), [SN74HC244-EP](#)
- Military : [SN54HC244](#)
- Space : [SN54HC244-SP](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

- Enhanced Product - Supports Defense, Aerospace and Medical Applications
- Military - QML certified for Military and Defense Applications
- Space - Radiation tolerant, ceramic packaging and qualified for use in Space-based application

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74HC244APWR	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.1	1.6	8.0	16.0	Q1
SN74HC244APWR	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1
SN74HC244DBR	SSOP	DB	20	2000	330.0	16.4	8.2	7.5	2.5	12.0	16.0	Q1
SN74HC244DBR	SSOP	DB	20	2000	330.0	16.4	8.2	7.5	2.5	12.0	16.0	Q1
SN74HC244DWR	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.8	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
SN74HC244DWR	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.9	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
SN74HC244DWRG4	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.8	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
SN74HC244NSR	SOP	NS	20	2000	330.0	24.4	8.4	13.0	2.5	12.0	24.0	Q1
SN74HC244NSR	SOP	NS	20	2000	330.0	24.4	8.4	13.0	2.5	12.0	24.0	Q1
SN74HC244PWR	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1
SN74HC244PWR	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1
SN74HC244QDWRG4Q1	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.8	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74HC244APWR	TSSOP	PW	20	2000	356.0	356.0	35.0
SN74HC244APWR	TSSOP	PW	20	2000	356.0	356.0	35.0
SN74HC244DBR	SSOP	DB	20	2000	356.0	356.0	35.0
SN74HC244DBR	SSOP	DB	20	2000	356.0	356.0	35.0
SN74HC244DWR	SOIC	DW	20	2000	367.0	367.0	45.0
SN74HC244DWR	SOIC	DW	20	2000	367.0	367.0	45.0
SN74HC244DWRG4	SOIC	DW	20	2000	367.0	367.0	45.0
SN74HC244NSR	SOP	NS	20	2000	367.0	367.0	45.0
SN74HC244NSR	SOP	NS	20	2000	367.0	367.0	45.0
SN74HC244PWR	TSSOP	PW	20	2000	356.0	356.0	35.0
SN74HC244PWR	TSSOP	PW	20	2000	356.0	356.0	35.0
SN74HC244QDWRG4Q1	SOIC	DW	20	2000	367.0	367.0	45.0

TUBE


*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
5962-8409601VSA	W	CFP	20	25	506.98	26.16	6220	NA
84096012A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
8409601SA	W	CFP	20	25	506.98	26.16	6220	NA
JM38510/65705B2A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
JM38510/65705BSA	W	CFP	20	25	506.98	26.16	6220	NA
M38510/65705B2A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
M38510/65705BSA	W	CFP	20	25	506.98	26.16	6220	NA
SN74HC244N	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
SN74HC244NE4	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
SNJ54HC244FK	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
SNJ54HC244W	W	CFP	20	25	506.98	26.16	6220	NA

J (R-GDIP-T**)

14 LEADS SHOWN

CERAMIC DUAL IN-LINE PACKAGE



DIM \ PINS **	14	16	18	20
A	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC
B MAX	0.785 (19,94)	.840 (21,34)	0.960 (24,38)	1.060 (26,92)
B MIN	—	—	—	—
C MAX	0.300 (7,62)	0.300 (7,62)	0.310 (7,87)	0.300 (7,62)
C MIN	0.245 (6,22)	0.245 (6,22)	0.220 (5,59)	0.245 (6,22)



4040083/F 03/03

- NOTES:
- All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - This drawing is subject to change without notice.
 - This package is hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
 - Index point is provided on cap for terminal identification only on press ceramic glass frit seal only.
 - Falls within MIL STD 1835 GDIP1-T14, GDIP1-T16, GDIP1-T18 and GDIP1-T20.

GENERIC PACKAGE VIEW

FK 20

LCCC - 2.03 mm max height

8.89 x 8.89, 1.27 mm pitch

LEADLESS CERAMIC CHIP CARRIER

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



4229370VA\

N (R-PDIP-T**)

PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE

16 PINS SHOWN



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - $\triangle C$ Falls within JEDEC MS-001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
 - $\triangle D$ The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.

DW0020A



PACKAGE OUTLINE

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



4220724/A 05/2016

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MS-013.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

DW0020A

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:6X



SOLDER MASK DETAILS

4220724/A 05/2016

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DW0020A

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:6X

4220724/A 05/2016

NOTES: (continued)

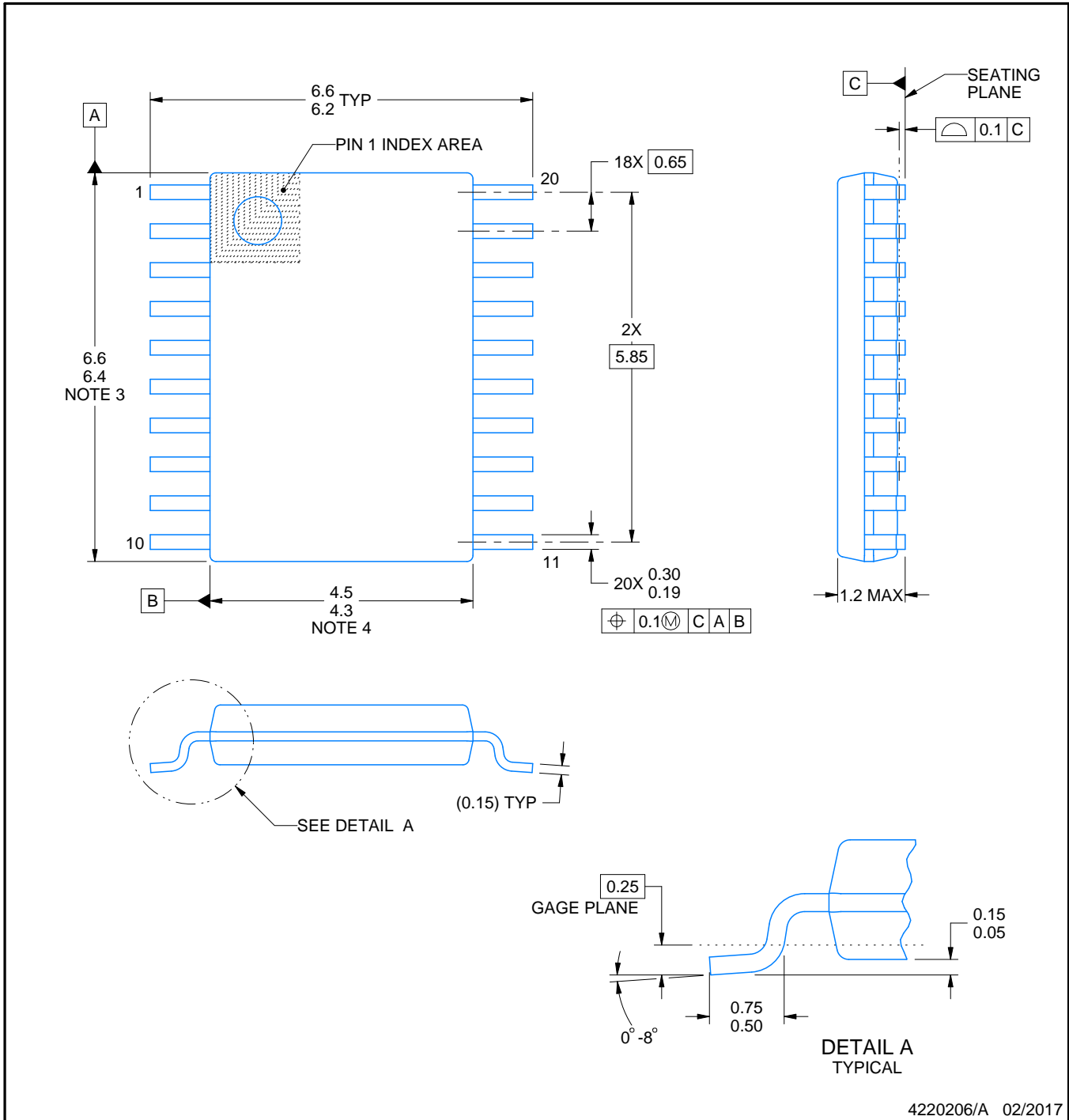
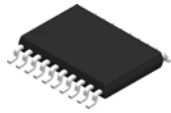
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

W (R-GDFP-F20)

CERAMIC DUAL FLATPACK



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. This package can be hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
 - D. Index point is provided on cap for terminal identification only.
 - E. Falls within Mil-Std 1835 GDFP2-F20



4220206/A 02/2017

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

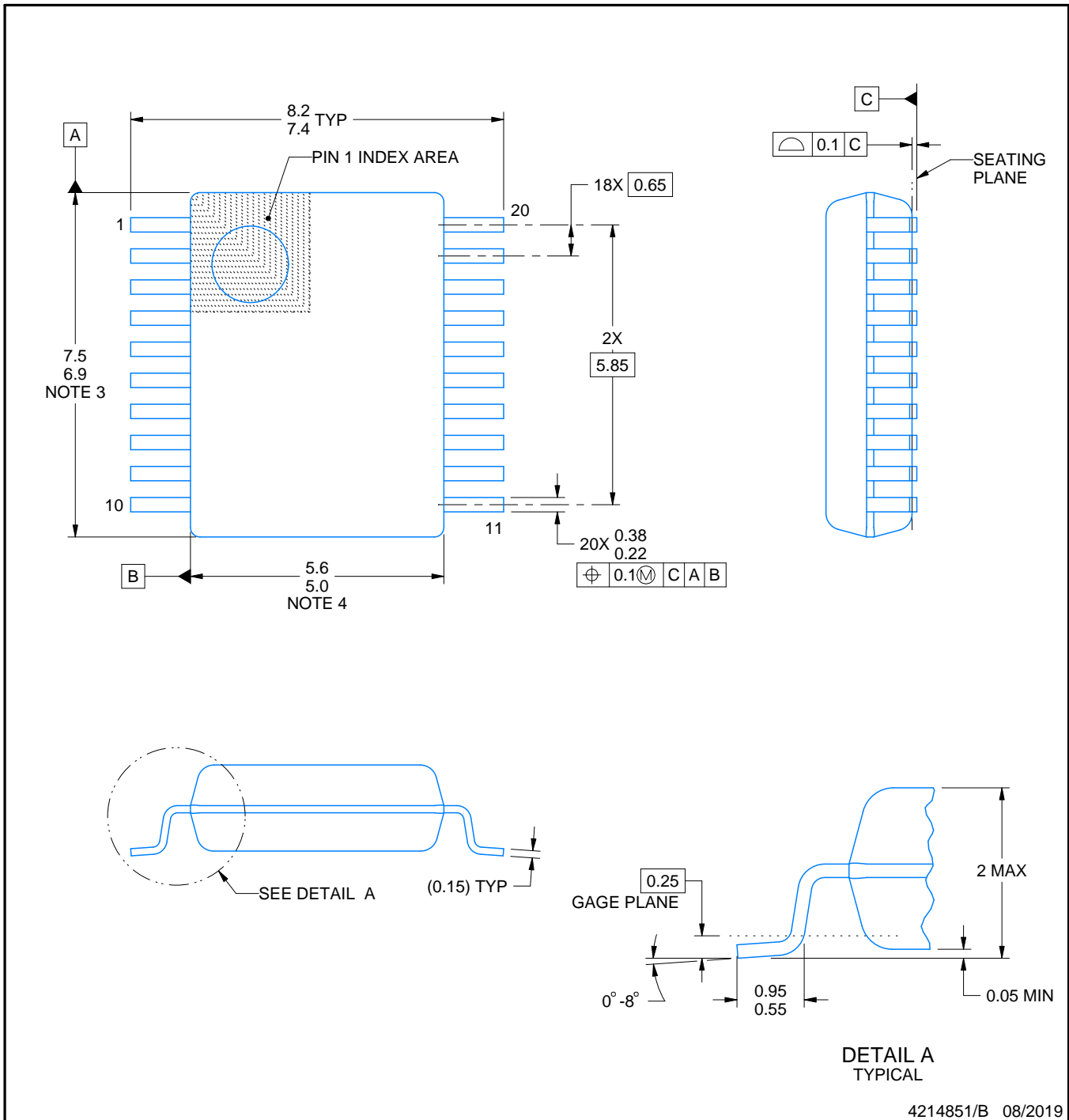
DB0020A



PACKAGE OUTLINE

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4214851/B 08/2019

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-150.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

DB0020A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



4214851/B 08/2019

NOTES: (continued)

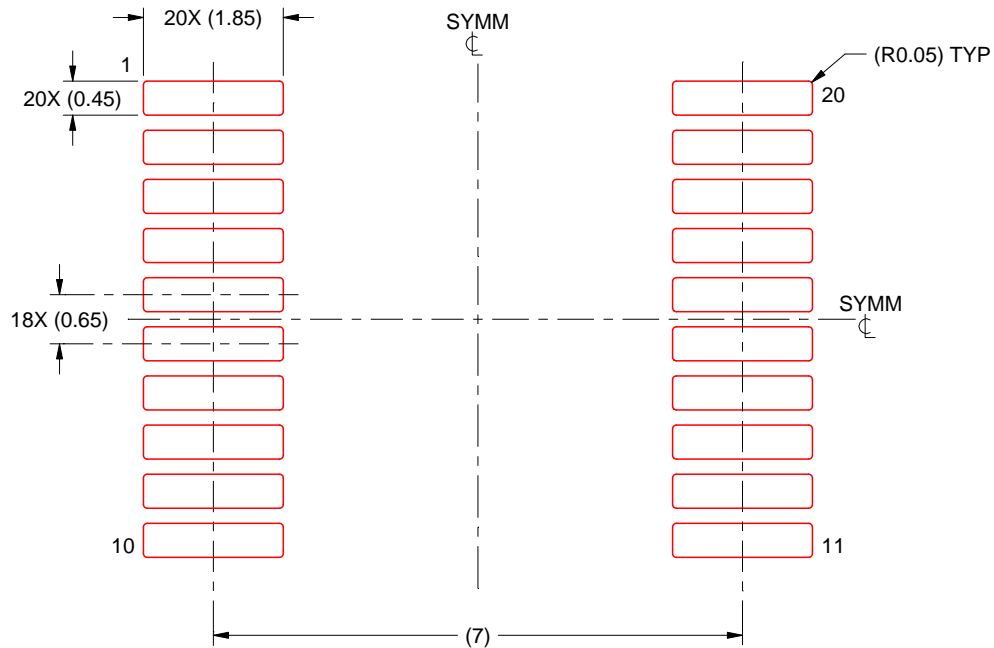
- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DB0020A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4214851/B 08/2019

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

MECHANICAL DATA

NS (R-PDSO-G**)

PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE

14-PINS SHOWN



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、ます。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated